

# 大功率电子元件密封胶，导热绝缘胶JR-9055

产品名称	大功率电子元件密封胶，导热绝缘胶JR-9055
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	80.00/件
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR-9055 厂家(产地):深圳杰瑞新材料
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

## 产品详情

### 加成型热传导电子元器件灌封胶JR 9055使用说明书

一、产品特征及应用JR 9055是一种低粘度防火阻燃的双组分加成型有机硅材料、热传导灌封胶，可以室温或者加温固化，温度越高固化越快。可用电子零件电缆护套、防渗漏除异味耐污，耐水洗化学物质，耐黄变，耐气候变老。切合实际欧盟成员国ROHS指令要求。

二、适用范围：1、大功率的电子元器件

2、散热和耐热要求较高的电源芯片和线路板的灌封机维护保养

三、运用制作工艺：

1. 混与前，首先把A成分B组分在各自的容器里充裕翻拌。

2. 按照重量比1:1的比例将A、B称重混合，搅拌均匀。

3. JR 9055应用中需根据需要进行除泡。可将A、B混合物翻拌再放入真空容器中，在0.08MPa下除泡5min，即可取出灌注使用。

4. 需要在凝固上下左右技术参数表中给出的工作温度之上，保持相对应的初凝，倘若应用厚薄偏厚，初凝很有可能超过。室温或升温凝固都可以。胶的固化速度受固化温度带来的影响，在冬季需很久才能够凝固，可使用加热方法凝固，80~100℃下凝固15min，室温条件下一般需8钟头凝固。

#### 四、固化前后技术参数：

性能指标		A组分	B组分
固 化 前 操 作 性 能	外观	灰色流体	白色流体
	粘度 (cps)	2500 ± 500	2500 ± 500
固 后	A组分：B组分 (重量比)	1：1	
	混合后黏度 (cps)	2000 ~ 3000	
	可操作时间 (min)	120	
	固化时间 (min, 室温)	480	
	固化时间 (min, 80 )	20	
	硬度(shore A)	55 ± 5	
	导热系数 [W (m · K) ]	0.8	
介电强度 (kV/mm)	25		
介电常数 (1.2MHz)	3.0 ~ 3.3		
体积电阻率 ( · cm)	1.0 × 10 <sup>16</sup>		
线膨胀系数 [m/ ( m · K) ]	2.2 × 10 <sup>-4</sup>		
阻燃性能	94-V1		

以上性能数据均在25℃，相对湿度55%固化1天后所测。本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。

#### 五、包装规格：

JR 9055：50Kg/套。(A成份25Kg B成份25Kg)

#### 六、储存及运输：

1.本产品的贮存期为1年（25℃之内）。

2.此类产品为非危险品，可以按照一般化工产品运输。3.超过保质期的产品应取少量测试，无异常方可继续使用。